

## Offre de prestation

# Découpe tous substrats avec une précision de 10 $\mu$ m



Equipements de découpe à disque et à fil (horizontale et verticale) à liant résine (poudre de diamant)

### VOS BESOINS

- Découper avec précision des cristaux plans nus ou déjà structurés (dépôt ou microcomposants)

### NOS SOLUTIONS

- Scie à disque pour tout matériaux jusqu'à 4"
- Scie à fil horizontale à liant résine pour une précision de positionnement maximum jusqu'à 3"
- Scie à fil verticale à liant résine pour des contraintes mécaniques minimum convenant aux substrats fins et fragiles jusqu'à 3"
- "Wafer scribe" pour les substrats silicium jusqu'à 6"

### MOTS-CLÉS

Découpe, Scribbing, Microcomposants

### COMPÉTENCES PROCHES


- Après découpe, il est possible de fixer et de connecter électriquement les composants sur carte PCB.
- Pour le cas du silicium, il est possible de graver uniquement en surface avec une pointe diamant sur "blue tape" pour un clivage ultérieur.
- Procédés de micro et nanofabrication

### NOS RÉFÉRENCES

### CONTACT


- Contact équipe :

 [juan-carlos.rojas-sanchez@univ-lorraine.fr](mailto:juan-carlos.rojas-sanchez@univ-lorraine.fr)

 +33 3 72 74 25 78

- Contact TTO, service dédié aux relations entreprises :

 [ijl-tto@univ-lorraine.fr](mailto:ijl-tto@univ-lorraine.fr)

 +33 3 72 74 26 04